

评级：增持（维持）

分析师：王芳

执业证书编号：S0740521120002

Email: wangfang02@zts.com.cn

分析师：杨旭

执业证书编号：S0740521120001

Email: yangxu01@zts.com.cn

分析师：李雪峰

执业证书编号：S0740522080004

Email: lixf05@zts.com.cn

分析师：游凡

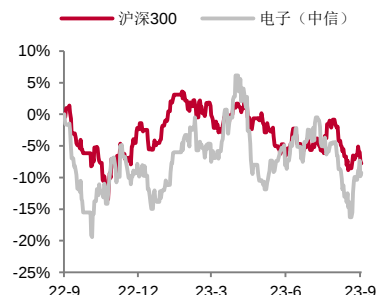
执业证书编号：S0740522120002

Email: youfan@zts.com.cn

基本状况

上市公司数	319
行业总市值(百万元)	4,423,711
行业流通市值(百万元)	2,289,162

行业-市场走势对比



相关报告

【中泰电子】半导体周跟踪：国家重视半导体产业发展，关注算力&国产化产业链布局

【中泰电子】半导体周跟踪：中芯国际 Q2 指引向好，看好行业复苏和国产替代主线

【中泰电子】半导体周跟踪：季报密集发布期，关注重点公司业绩

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		2021	2022	2023E	2024E	2021	2022	2023E	2024E		
韦尔股份	93	3.8	0.8	1.8	2.9	25	115	51	32	0.5	买入
兆易创新	100	3.5	3.1	1.6	2.8	29	32	61	35	0.5	买入
圣邦股份	80	1.5	1.8	1.3	2.0	53	44	61	39	0.7	买入
士兰微	25	1.1	0.7	1.1	1.4	24	34	23	18	0.6	买入
复旦微电	49	0.6	1.4	1.8	2.4	77	36	27	20	0.7	买入
江丰电子	67	0.4	0.9	1.6	2.4	166	74	42	28	0.6	买入
北方华创	249	2.0	4.8	4.6	6.1	123	52	54	41	1.3	买入
兴森科技	12	0.4	0.3	0.3	0.5	33	42	41	23	0.3	买入

备注：股价取自 2023 年 9 月 15 日收盘价

投资要点

■ 市场整体下跌，半导体指数跌 1.51%

当周(2023/9/11-2023/9/15)市场整体下跌，沪深 300 指数跌 0.83%，上证综指涨 0.05%，深证成指跌 1.34%，创业板指数跌 2.29%，中信电子跌 2.31%，半导体指数跌 1.51%。其中：半导体设计跌 0.3%，半导体制造跌 1.0%，半导体封测跌 3.0%，半导体材料跌 0.8%，半导体设备跌 5.8%，功率半导体跌 1.2%。

目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及 Chiplet 等投资机遇。

■ 行业新闻

1) 台积电 3nm 产量将大幅增加，已预计 6.5 万片晶圆

据业内人士透露，台积电已将 3nm 工艺技术部署到量产，苹果是其首个客户，台积电准备在 2024 年执行其他主要客户的更多 3nm 芯片订单。台积电已制造出全球首款 3nm 智能手机芯片——苹果 A17 Pro，该芯片为新款 iPhone 15 Pro 系列提供支持。消息人士称，台积电将于 2024 年开始履行更多 3nm 订单承诺，届时 3nm 工艺系列的产量将大幅增加。目前该代工厂的 3nm 工艺产量预计约为 6.5 万片晶圆。

2) 华为官方宣布将于 9 月 25 日举行秋季全场景新品发布会

华为日前推出「先锋计划」，尚未发布的 Mate60 系列、Mate X5 史无前例地提前发售，引发了全网讨论和抢购。此前供应链称，华为 Mate60 Pro 已加单至 1500 万至 1700 万台。而《IT 时报》记者从产业链人士处获知，华为 Mate60 Pro 和 Mate60 Pro+ 的出货量已上调至 2000 万台。根据官方预热，华为新一代旗舰耳机——华为 FreeBuds Pro 3 即将在发布会上亮相。9 月 14 日，华为也公布了折叠新机 Mate X5 的售价，12999 元起售，并于当天 10:08 启动全款销售。

3) 全球年内最大 IPO 芯片设计公司 Arm 上市

全球年内最大 IPO 芯片设计公司 Arm 在纳斯达克上市，IPO 定价为每股 51 美元，首日收涨 24%，市值达 652 亿美元。软银集团在今年最大的首次公开募股中筹集了 48.7 亿美元，满足了其对 Arm 的雄心，同时抵制住了尝试更多资金的诱惑。Arm 的公开估值接近 600 亿美元，该公司的股票代码为“ARM”，售出约 9550 万股。软银于 2016 年将该公司私有化，控制着约 90% 的流通股。

■ 重要公告

思瑞浦: 9月14日,公司发布关于持股5%以上股东自愿延长锁定期等相关承诺的公告。基于对公司未来发展前景的信心和对内在价值的认可,公司股东ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》,承诺:ZHIXU ZHOU所持公司首次公开发行前取得的9,988,648股股份(占公司当前总股本的8.31%)、苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)所持公司首次公开发行前取得的9,920,712股股份(占公司当前总股本的8.25%),自2023年9月20日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2024年3月20日。

闻泰科技: 公司9月13日公告,公司拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司、实际控制人张学政先生持有的上海闻天下置业有限公司(以下简称“闻天下置业”)和上海闻宙电子科技有限公司(以下简称“闻宙电子”)100%股权,其中闻天下置业的核心资产为一栋位于上海市普陀区正在办理房产证的办公大楼,闻宙电子的核心资产为一项位于上海市普陀区的在建工程。

■ 投资建议:

建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇:

- (1) AI应用: 大华股份、海康威视;
- (2) 服务器产业链: 寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康;
- (3) C端AI应用: 瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者;
- (4) Chiplet: 通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。

国产化产业链机会:

- (1) 设备: 中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子;
- (2) 零部件: 福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材;
- (3) 材料: 沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。

静待周期复苏:

存储: 兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份;

模拟: 圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。

■ 风险提示: 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

内容目录

一、行情回顾：市场整体下跌，半导体指数跌 1.51%	- 4 -
二、行业新闻：台积电 3nm 产量大幅增加，已预计 6.5 万片晶圆	- 7 -
三、板块跟踪：关注景气度复苏弹性与国产替代机遇	- 9 -
四、重要公告：思瑞浦发布关于持股 5%以上股东自愿延长锁定期等相关承诺	- 10 -
五、投资建议	- 10 -
六、风险提示	- 12 -

一、行情回顾：市场整体下跌，半导体指数跌 1.51%

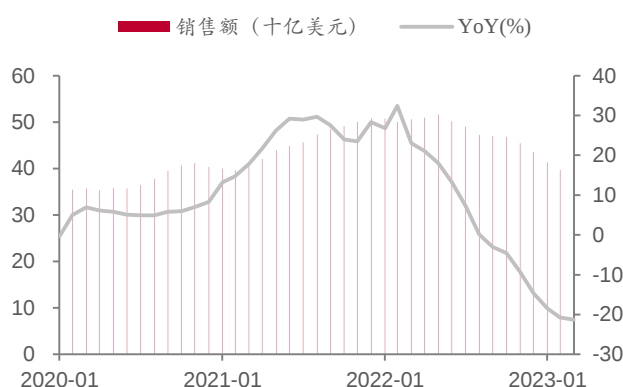
- 当周（2023/9/11-2023/9/15）市场整体下跌，沪深 300 指数跌 0.83%，上证综指涨 0.05%，深证成指跌 1.34%，创业板指数跌 2.29%，中信电子跌 2.31%，半导体指数跌 1.51%。其中：半导体设计跌 0.3%，半导体制造跌 1.0%，半导体封测跌 3.0%，半导体材料跌 0.8%，半导体设备跌 5.8%，功率半导体跌 1.2%。
- 当周（2023/9/11-2023/9/15）费城半导体指数下跌，跌幅为 2.51%，2023/01/01-2023/9/15 涨幅 37.29%。台湾半导体指数周上涨 3.78%，2023/01/01-2023/9/15 涨幅为 26.29%。

图表 1：费城半导体指数



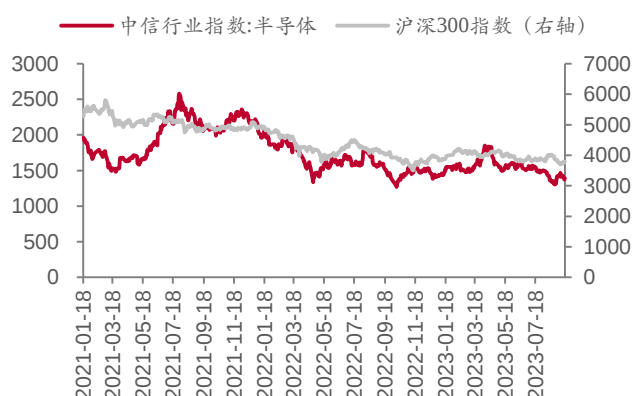
来源：wind，中泰证券研究所

图表 2：全球半导体月度销售额及增速



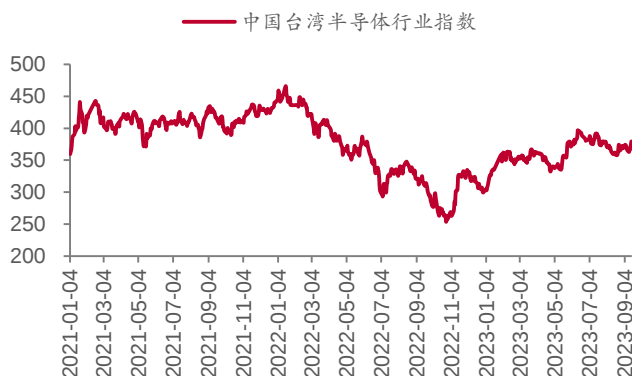
来源：wind，中泰证券研究所

图表 3：A 股半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

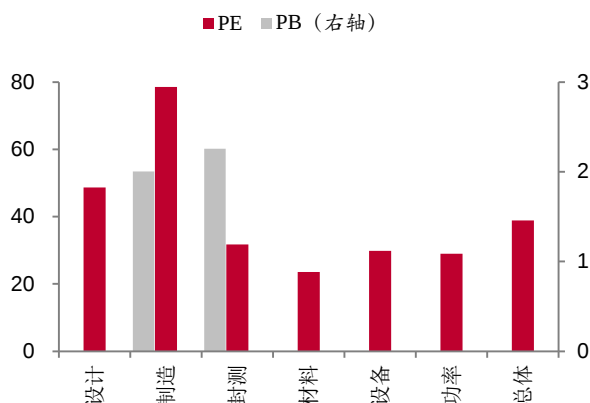
图表 4：中国台湾半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

图表 5：细分板块估值情况（2023）

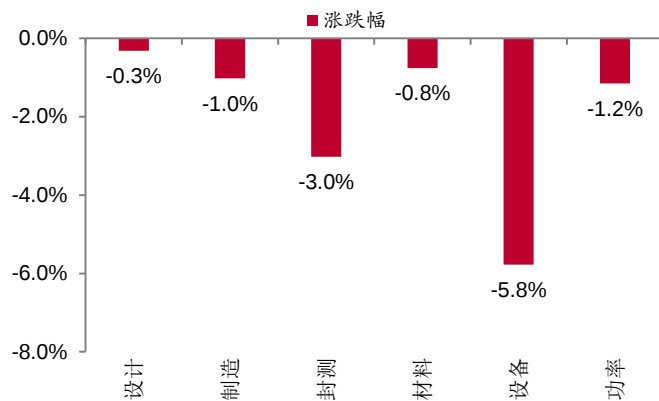
图表 6：当周半导体各细分板块涨跌幅情况



来源: wind, 中泰证券研究所

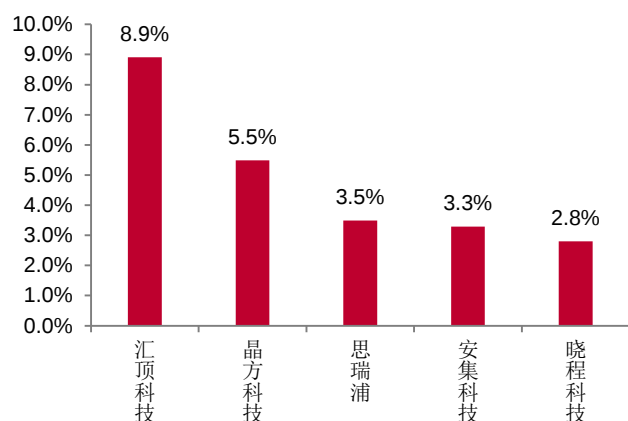
注: PE=最近市值/2023 年 wind 一致预期净利润

注: PB=最近市值/2023 年 wind 一致预期净资产



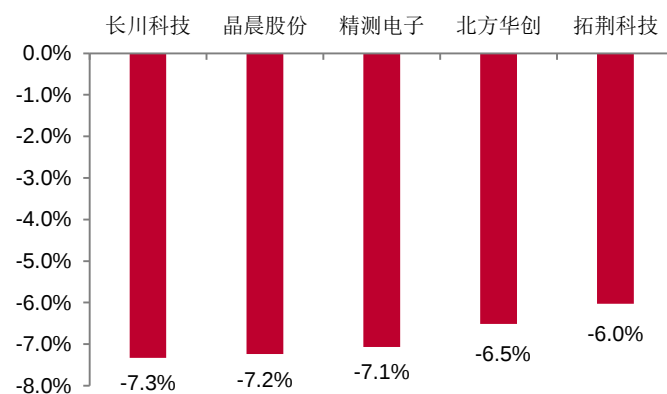
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



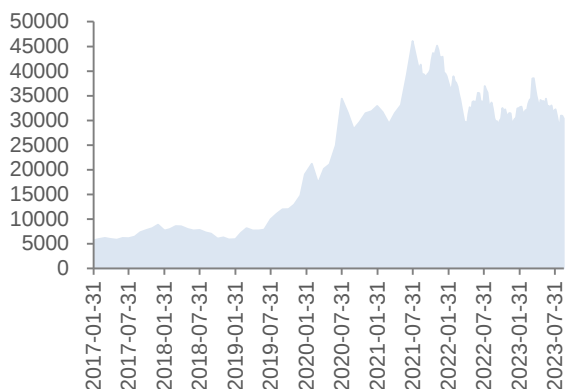
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司

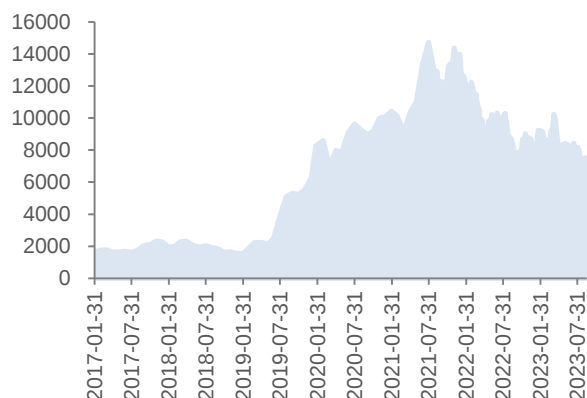


来源: wind, 中泰证券研究所

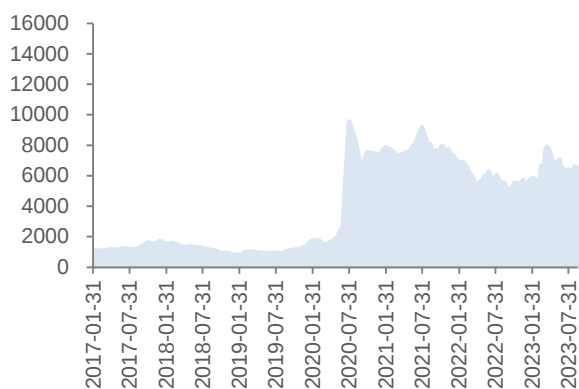
- 截至 9 月 15 日, A 股半导体公司总市值达 30379 亿元, 环比跌 1.75%。其中: 设计板块公司总市值 7462 亿元, 环比跌 0.85%; 制造板块公司总市值 6482 亿元, 环比跌 0.7%; 设备板块公司总市值 5482 亿元, 环比跌 4.66%; 材料板块公司总市值 3803 亿元, 环比跌 1.24%; 封测公司总市值 1754 亿元, 环比跌 2.83%; 功率板块总市值 5627 亿元, 环比跌 1.13%。

图表 9: A 股半导体板块公司总市值 (亿元)


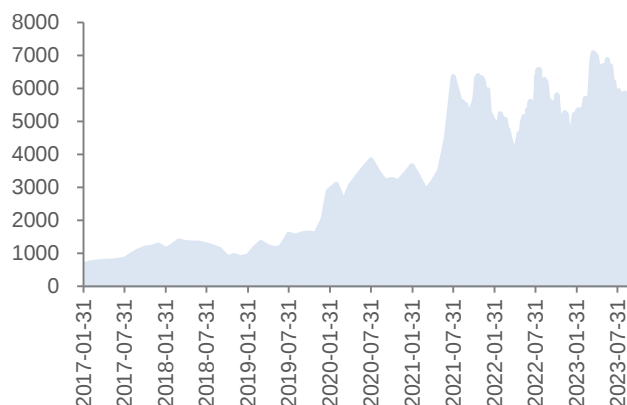
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (亿元)


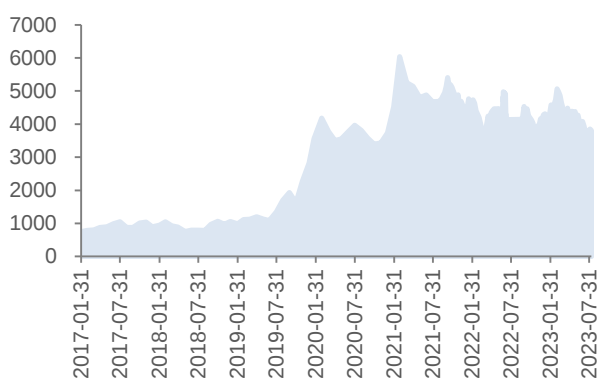
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 11: A 股半导体制造板块公司总市值 (亿元)


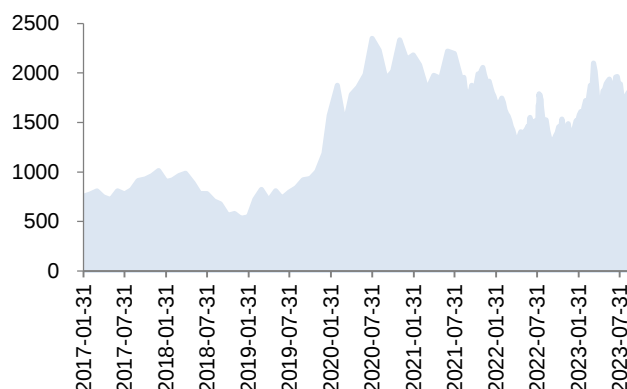
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (亿元)


来源: wind, 中泰证券研究所

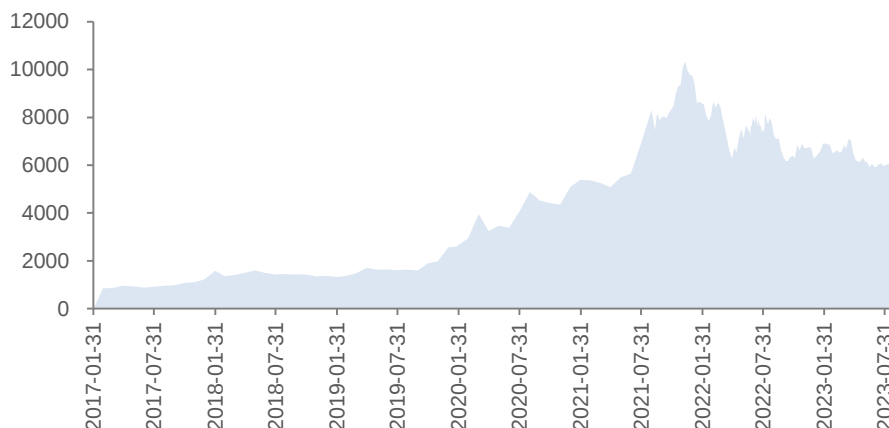
图表 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (亿元)


来源: wind, 中泰证券研究所

图表 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (亿元)


来源: wind, 中泰证券研究所

图表 15: A 股功率板块公司总市值 (亿元)



来源: wind, 中泰证券研究所

- 当周（2023/9/11/-2023/9/15）沪/深股通总体增持半导体板块。本周沪/深股通持股市值前 20 的企业中，11 家企业获增持，9 家企业被减持。增持金额前三公司为三安光电（1.79 亿元）、汇顶科技（0.97 亿元）、兆易创新（0.87 亿元），减持金额前三公司为晶盛机电（-3.51 亿元）、大族激光（-1.12 亿元）、紫光国微（-1.05 亿元）。

图表 16：沪/深股通半导体板块持仓情况（按持股市值排名）

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金 额(百万元)	沪(深)股通持股市 值 (百万元)	沪(深)股通持股占 自由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	7	19	3205	11685	17
2	2	300316.SZ	晶盛机电	-351	-485	2129	6050	20
3	3	002371.SZ	北方华创	-24	-302	125	5159	8
4	4	002129.SZ	TCL中环	35	473	253	4747	7
5	5	688012.SH	中微公司	65	-880	408	4029	7
6	6	300782.SZ	卓胜微	18	-36	840	3288	8
7	7	688008.SH	澜起科技	-2	-289	956	2712	6
8	8	603986.SH	兆易创新	87	31	73	2582	4
9	9	600584.SH	长电科技	80	305	907	2218	5
10	11	600745.SH	闻泰科技	15	109	214	1720	5
11	10	002049.SZ	紫光国微	-105	26	-1319	1638	3
12	12	603290.SH	斯达半导	-16	-110	-2076	1604	11
13	13	300661.SZ	圣邦股份	-3	-97	-1038	1359	6
14	14	300054.SZ	鼎龙股份	16	22	268	1183	8
15	16	002180.SZ	纳思达	11	308	543	1078	5
16	18	603160.SH	汇顶科技	97	334	864	1,049	7
17	20	600703.SH	三安光电	179	290	951	1,000	2
18	15	002008.SZ	大族激光	-112	-579	-2419	991	5
19	17	688396.SH	华润微	-23	-18	66	873	4
20	19	688200.SH	华峰测控	-9	12	-196	823	8

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价, 数据更新截止于 2023/9/15;

二、行业新闻：台积电 3nm 产量大幅增加，已预计 6.5 万片晶圆

■ 台积电 3nm 产量将大幅增加，已预计 6.5 万片晶圆

据业内人士透露,台积电已将 3nm 工艺技术部署到量产,苹果是其首个客户,台积电准备在 2024 年执行其他主要客户的更多 3nm 芯片订单。台积电已制造出全球首款 3nm 智能手机芯片——苹果 A17 Pro,该芯片为新款 iPhone 15 Pro 系列提供支持。消息人士称,台积电将于 2024 年开始履行更多 3nm 订单承诺,届时 3nm 工艺系列的产量将大幅增加。目前该代工厂的 3nm 工艺产量预计约为 6.5 万片晶圆。

链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/LBMi2ZqZSXzZiPRXD-IN9w>

■ 全球年内最大 IPO 芯片设计公司 Arm 上市

全球年内最大 IPO 芯片设计公司 Arm 在纳斯达克上市，IPO 定价为每股 51 美元，首日收涨 24%，市值达 652 亿美元。软银集团在今年最大的首次公开募股中筹集了 48.7 亿美元，满足了其对 Arm 的雄心，同时抵制住了尝试更多资金的诱惑。Arm 的公开估值接近 600 亿美元，该公司的股票代码为“ARM”，售出约 9550 万股。软银于 2016 年将该公司私有化，控制着约 90% 的流通股。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/I5gTTFWtrorHO2hprdCvpA>

■ 台积电要设备商延迟出货，ASML 受连累

据消息，台积电暂时推迟了部分先进芯片制造设备的交付，“短期”推迟设备接收，作为削减成本的措施，同时更好地处理客户需求。荷兰 ASML 可能是受延误影响的设备供应商之一。ASML 首席执行官 Peter Wennink 上周在接受路透社采访时表示，其高端设备的一些订单已被推迟，但未透露具体客户的名称。ASML 是台积电的重要供应商。这些机器用于为 Nvidia、Apple、AMD 和高通等公司生产 7nm 以下工艺节点，所有这些公司都与台积电签订了制造合同。延误发生之际，台积电正努力应对经济状况疲软和半导体需求下滑的问题。

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/9BwZlYjV_OK80ppmGjG7rA

■ 投资 40 亿美元 格芯新加坡扩建晶圆厂正式开业

9 月 12 日，格芯宣布其在新加坡投资 40 亿美元扩建的制造厂正式开业。23000 平方米的晶圆厂将在新加坡创造 1000 个高价值工作岗位，其中 95% 将包括设备技术人员，工艺技术人员和工程师，扩建后的晶圆厂每年将额外生产 45 万片 300 毫米晶圆，将格芯新加坡的总产能提高到每年约 150 万片 300 毫米晶圆。

据路透社报道，格芯新加坡总经理 Tan Yew Kong 表示：“如果我们充分利用新加坡工厂的产能，这可能会占格芯收入的 45% 左右。公司预计到 2024 年下半年，全球对芯片的需求将会回升。”格芯的新加坡业务为全球 200 家客户提供服务，还包括另外两家工厂，每年分别生产 72 万片 300 毫米晶圆和 69.2 万片 200 毫米晶圆，这些芯片用于汽车和 5G 技术。市调机构 TrendForce 的数据显示，按收入计算，格芯是全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电和三星电子。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/ZfNdL0ZHhIKG85341msafg>

■ 华为官方宣布将于 9 月 25 日举行秋季全场景新品发布会

华为日前推出「先锋计划」，尚未发布的 Mate60 系列、Mate X5 史无前例地提前发售，引发了全网讨论和抢购。此前供应链称，华为 Mate60 Pro 已加单至 1500 万至 1700 万台。而《IT 时报》记者从产业链人士处获知，华为 Mate60 Pro 和 Mate60 Pro+ 的出货量已上调至 2000 万台。根据官方预热，华为新一代旗舰耳机——华为 FreeBuds Pro 3 即将在发布会上亮相。9 月 14 日，华为也公布了折叠新机 Mate X5 的售价，12999 元起售，并于当天 10:08 启动全款销售。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/O2TI-Ebgt2uMLjgn0SJpMg>

■ iPhone15 全系灵动岛，告别刘海屏闪电接口，5999 起卖

北京时间 9 月 13 日凌晨 1 点，2023 苹果秋季发布会盛大举行，发布会带来全新的 iPhone 15 系列，同样有 6.1 和 6.7 两种屏幕尺寸，改变的地方有芯片、影像、机身材质、连接表现等。本次发布会，苹果一共发布了 4 款 iPhone 15 系列手机，分别是 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。所有 iPhone 15 新机均 9 月 15 日周五起接受预订，9 月 22 日下周五开始发售。

截至当地时间 9 月 12 日，苹果收报 176.3 美元，跌幅 1.71%，市值 2.8 万亿美元。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/91UNbc2H0ifkDSHUD0LqQg>

■ NAND Flash 第二季营收环比增长 7.4%，第四季价格有望止跌回升

据 TrendForce 集邦咨询研究显示，第二季 NAND Flash 市场需求仍低迷，供过于求态势延续，使 NAND Flash 第二季平均销售单价（ASP）续跌 10~15%，而位元出货量在第一季低基期下环比增长达 19.9%，合计第二季 NAND Flash 产业营收环比增长 7.4%，营收约 93.38 亿美元。

近日，三星（Samsung）为应对需求持续减弱，宣布 9 月起扩大减产幅度至 50%，减产仍集中在 128 层以下制程为主，据 TrendForce 集邦咨询调查，其他供应商预计也将跟进扩大第四季减产幅度，目的加速库存去化速度，预估第四季 NAND Flash 均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约 0~5%。

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/nuljblJHxCNTH8DzCy_T9w

三、板块跟踪：关注景气度复苏弹性与国产替代机遇

- **模拟**：当周模拟芯片设计（申万三级）板块-3.86%，板块回调。模拟 IC 设计板块受周期下行和高研发投入影响，主要公司短期业绩承压。目前行业至暗时刻已过，模拟 IC 具备长周期成长属性，重视低位反转&高成长模拟赛道标的，关注主要标的库存、下游景气度变化，复苏进度或出现分化。
- **MCU**：本周板块震荡，涨跌幅-5%~+3%不等。
- **存储**：本周板块震荡，涨跌幅-7%~+5%。存储股价&估值&盈利大弹性，复苏量价齐升逻辑最佳，行业基本面持续向好，持续看好大弹性与强周期。
- **功率**：本周 IGBT 指数下降 2.1%。东微半导体下降 3.8%，捷捷微电下降 3.1%，宏微科技下降 2.7%，新洁能下降 2.6%。功率板块从边际趋势看，市场担忧 IGBT 景气中长期的周期变化。
- **设备**：Wind 半导体设备指数本周下降 3.0%，长川科技下降 7.3%，精测电子下降 7.1%，北方华创下降 6.5%，拓荆科技下降 6.0%，芯源微下降 5.7%，盛美上海上涨 1.3%。中长期来看，设备国产化作为国家战略方向，国产替代进程有望加速推进，我们持续看好设备板块。
- **制造**：本周中芯国际 A 股下降 1.52%，中芯国际 H 股上涨 0.40%，华虹半导体上涨 1.06%，华虹公司下降 4.88%。当前国家高度重视半导体产业，

需重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位,同时我们也看好景气复苏后对制造公司产能利用率和盈利的改善,未来中芯国际、华虹半导体的扩产有望支撑其在国内份额的提升。

- **封测:** 本周华天科技下降 0.98%, 晶方科技上涨 5.48%, 通富微电下降 3.63%, 长电科技下降 6.00%。中长期来看, 景气复苏预期+chiplet 渗透率提升双重催化, 我们看好封测板块。
- **光刻胶:** 光刻胶板块本周整体下跌, 其中华懋科技涨 4.30%, 彤程新材涨 0.22%, 南大光电跌 1.03%, 雅克科技跌 1.74%, 上海新阳跌 3.41%, 晶瑞电材跌 5.35%。目前中高端 KrF、ArF 国产化率极低, 作为壁垒最高的半导体材料之一, 光刻胶的自主化已成为国家战略, 下游晶圆厂验证意愿持续加强, 给国产光刻胶的切换与导入带来历史性机遇。此外, 随着中美摩擦进一步演化, 美国、日本对国内先进制程的封锁或将进一步延伸到半导体关键材料, 光刻胶国产替代有望提速。
- **硅片:** 本周半导体材料硅片板块震荡, 其中 TCL 中环下跌 2.87%, 沪硅产业上涨 0.64%, 立昂微上涨 0.74%, 中晶科技上涨 0.34%, 神工股份下跌 1.17%。

四、重要公告: 思瑞浦发布关于持股 5%以上股东自愿延长锁定期等相关承诺

- **思瑞浦:** 9 月 14 日, 公司发布关于持股 5%以上股东自愿延长锁定期等相关承诺的公告。基于对公司未来发展前景的信心和对内在价值的认可, 公司股东 ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》, 承诺: ZHIXU ZHOU 所持公司首次公开发行前取得的 9,988,648 股股份(占公司当前总股本的 8.31%)、苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)所持公司首次公开发行前取得的 9,920,712 股股份(占公司当前总股本的 8.25%), 自 2023 年 9 月 20 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 3 月 20 日。
- **闻泰科技:** 公司 9 月 13 日公告, 公司拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司、实际控制人张学政先生持有的上海闻天下置业有限公司(以下简称“闻天下置业”)和上海闻宙电子科技有限公司(以下简称“闻宙电子”)100%股权, 其中闻天下置业的核心资产为一栋位于上海市普陀区正在办理房产证的办公大楼, 闻宙电子的核心资产为一项位于上海市普陀区的在建工程。

五、投资建议

- **建议关注 AI 以算力为基础的芯片供应链机遇:**
 - (1) AI 应用: 大华股份、海康威视;
 - (2) 服务器产业链: 寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康;
 - (3) C 端 AI 应用: 瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者;
 - (4) Chiplet: 通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。

■ 国产化产业链机会:

- (1) 设备: 中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子;
- (2) 零部件: 福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材;
- (3) 材料: 沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。

■ 静待周期复苏:

- (1) 存储: 兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份;
- (2) 模拟: 圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。

图表 17: 盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价	EPS				PE			评级
		2023/9/17	2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E		
603501.SH	韦尔股份	93	0.8	1.8	2.9	115	51	32	买入	
603986.SH	兆易创新	100	3.1	1.6	2.8	32	61	35	买入	
300327.SZ	中颖电子	26	0.9	0.8	1.0	28	33	25	买入	
688595.SH	芯海科技	30	0.0	0.2	1.6	1444	137	19	NA	
300661.SZ	圣邦股份	80	1.8	1.3	2.0	44	61	39	买入	
688173.SH	希荻微	18	0.0	0.2	0.3	-488	109	67	买入	
688536.SH	思瑞浦	190	2.2	3.6	5.5	86	52	34	NA	
300782.SZ	卓胜微	126	2.0	2.0	3.5	63	62	36	NA	
600460.SH	士兰微	25	0.7	1.1	1.4	34	23	18	买入	
300373.SZ	扬杰科技	36	2.0	2.8	3.4	18	13	11	买入	
603290.SH	斯达半导	188	4.8	6.8	9.4	39	28	20	买入	
688711.SH	宏微科技	52	0.5	1.1	1.6	101	46	33	买入	
605358.SH	立昂微	34	1.0	2.1	2.5	34	16	14	买入	
300666.SZ	江丰电子	67	0.9	1.6	2.4	74	42	28	买入	
688126.SH	沪硅产业	21	0.1	0.1	0.2	164	164	127	买入	
002436.SZ	兴森科技	12	0.3	0.3	0.5	42	41	23	买入	
002409.SZ	雅克科技	67	1.1	1.7	2.5	58	38	27	NA	
300054.SZ	鼎龙股份	21	0.5	0.5	0.7	44	47	28	NA	
688019.SH	安集科技	166	3.0	4.0	5.3	55	42	31	NA	
688268.SH	华特气体	68	1.7	2.2	2.9	40	30	23	NA	
688106.SH	金宏气体	26	0.5	0.7	0.8	52	39	31	NA	
002371.SZ	北方华创	249	4.8	4.6	6.1	52	54	41	买入	
688037.SH	芯源微	139	1.5	2.1	2.9	95	67	48	买入	
688200.SH	华峰测控	135	3.9	4.7	5.9	35	29	23	买入	
688012.SH	中微公司	145	1.9	2.2	2.9	77	64	49	买入	
688630.SH	芯基微装	72	1.0	1.6	2.3	69	45	31	NA	
688981.SH	中芯国际	52	1.8	0.8	1.1	28	69	48	NA	
1347.HK	华虹半导体	20	0.2	0.1	0.2	130	157	133	NA	
600584.SH	长电科技	31	1.8	1.2	1.8	17	26	17	买入	
603005.SH	晶方科技	24	0.3	0.4	0.8	68	53	29	NA	
002156.SZ	通富微电	20	0.4	0.6	0.8	56	35	25	买入	
000021.SZ	深科技	18	0.4	0.6	0.7	42	29	25	NA	

002185.SZ	华天科技	9	0.2	0.2	0.4	38	42	24	NA
688385.SH	复旦微电	49	1.4	1.8	2.4	36	27	20	买入
688107.SH	安路科技	44	0.1	0.3	0.4	298	176	101	买入
603893.SH	瑞芯微	63	0.7	2.5	3.3	89	25	19	买入
688008.SH	澜起科技	52	1.1	0.7	1.9	45	74	27	NA
688099.SH	晶晨股份	68	1.8	2.8	3.2	39	24	22	NA

来源：wind，中泰证券研究所

注：已覆盖公司采用我们预测值，未覆盖公司采用 wind 一致预期。

六、风险提示

- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。